

TLC69697-Q1 适用于 TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 器件系列的汽车级 UART 兼容型连接

1 特性

- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
 - 1 级：-40°C 至 125°C 环境温度
 - 器件 HBM 分类等级 H2
 - 器件 CDM 分类等级 C5
- 工作电压 V_{CC} 范围：2.7V 至 5.5V
- 控制接口选项
 - 时的 UART 串行通信
 - 数据传输速率高达 4MHz
 - 在单条总线上支持 4 个外设
 - 兼容 CAN 收发器
- LED 驱动器 SPI 控制器
 - 数据传输速率高达 6.6MHz
 - 用于增强 EMI 性能的可编程时钟抖动
- 保护和诊断
 - 开漏 FAULT 引脚
 - UART 通信丢失检测
 - 用于通信的 CRC

2 应用

- UART 兼容型连接，适用于

- TLC69637Q1 和 TLC69627Q1
- TLC69634Q1 和 TLC69624Q1
- TLC69631Q1 和 TLC69621Q1
- TLC69638Q1 和 TLC69628Q1
- TLC69635Q1 和 TLC69625Q1
- TLC69632Q1 和 TLC69622Q1
- TLC69620Q1 和 TLC69630Q1

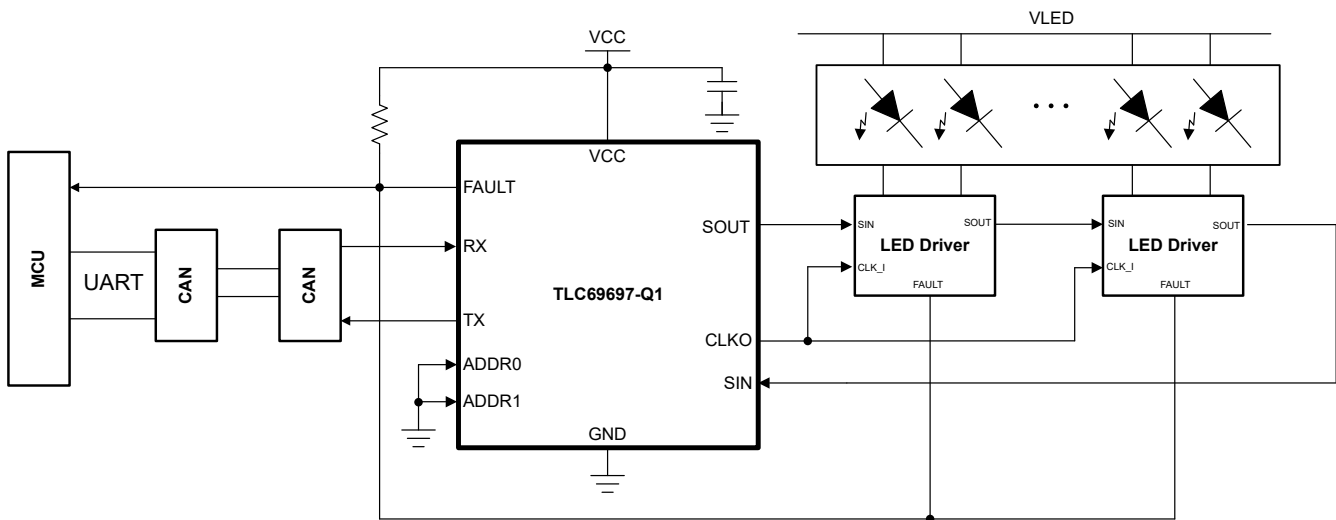
3 说明

TLC69697-Q1 UART 兼容型连接支持使用单个 UART 控制器控制 TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 器件系列。该器件具有一个内部振荡器，用于生成 TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 器件系列 SPI 所需的时钟。传输的数据与时钟对齐，以保持串行外设接口 (SPI) 的时序要求。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
TLC69697-Q1	SOT-23-THN (14)	4.20mm x 2.00mm

- (1) 有关所有可用封装，请参阅机械、封装和可订购信息部分。
 (2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值。



典型应用图



内容

1 特性.....	1	6.2 支持资源.....	5
2 应用.....	1	6.3 商标.....	5
3 说明.....	1	6.4 静电放电警告.....	5
4 器件比较表.....	3	6.5 术语表.....	5
5 引脚配置和功能.....	4	7 修订历史记录.....	5
6 器件和文档支持.....	5	8 机械、封装和可订购信息.....	5
6.1 接收文档更新通知.....	5		

4 器件比较表

器件型号	材料	封装
TLC69697-Q1	TLC69697QDYRQ1	SOT-23-THN (14)

5 引脚配置和功能

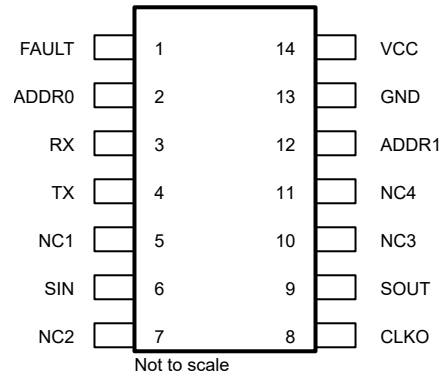


图 5-1. TLC69697-Q1 DYY 封装，14 引脚 SOT-23-THN (顶视图)

表 5-1. 引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	DYY 编号		
ADDR0	2	I	UART 接口的地址 0。
ADDR1	12	I	UART 接口的地址 1。
CLKO	8	O	SPI 时钟输出。
故障	1	O	故障指示灯：开漏输出。
GND	13	G	接地引脚。
NC1	5	NC	无连接。
NC2	7	NC	无连接。
NC3	10	NC	无连接。
NC4	11	NC	无连接。
RX	3	I	UART RX。
SIN	6	I	SPI 数据输入。
SOUT	9	O	SPI 数据输出。
TX	4	O	UART TX。
VCC	14	P	VCC 电源输入。

(1) I = 输入，O = 输出，I/O = 输入或输出，G = 接地，P = 电源。

6 器件和文档支持

TI 提供广泛的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

6.1 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

6.2 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

6.3 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

6.4 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

6.5 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

7 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

日期	修订版本	注释
February 2026	*	初始发行版

8 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月